****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*congatec’s COM Express module with AMD Embedded G-Series SOC delivers up to 30% more graphics performance*

*Text and photo available at:* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**congatec présente son module COM Express avec SoC AMD G-Series**

Le nouveau module conga-TR3 équipé d'un SOC AMD G-Series apporte jusqu'à + 30% de performances graphiques et de la RAM DDR4 rapide.

Paris -- 23 février 2016 -- congatec, acteur de premier plan dans le domaine des modules processeurs embarqués, des cartes SBC et des services EDM, vient d'agrandir sa gamme COM Express avec le lancement du nouveau module AMD G-Series SOC (nom de code Brown Falcon). Par aux modules de la génération précédente, le nouveau conga-TR3 équipé du processeur AMD GX-217GI fournit jusqu'à +30% de performances graphiques et 15% de performances système supplémentaires. De plus, l'AMD G-Series SOC prend en charge la mémoire DDR4 plus rapide et plus efficace énergétiquement, le PCI Express Gen 3.0 pour les extensions spécifiques des clients ainsi que la puissante accélération graphique avec DirectX 12. Ce nouveau module est donc le choix idéal pour de nombreuses applications embarquées. Avec un TDP configurable maximal de 12-15 watts, il convient aussi parfaitement aux designs sans ventilateur.

Comme ces nouveaux processeurs AMD G-Series sont compatibles au niveau broches avec les SOC AMD Embedded R-Series (appelés Merlin Falcon) et proviennent de la même microarchitecture de processeur, les OEM disposent d'une extrême scalabilité qui leur permet de mettre en oeuvre rapidement et efficacement des solutions d'entrée de gamme comme haut de gamme avec un seul module. Dans le domaine des performances graphiques intensives, le nouveau module conga-TR3 dispose du meilleur prix pour les applications en volume.

Le spectre des applications s'étend des jeux riches en graphiques et les applications de signalisation numérique avec deux écrans 4K, de l'analyse de l'image et vidéo dans les systèmes de vision industriels, l'imagerie médicale, la grande distribution, les points de vente et l'automatisation. Le module peut aussi être utilisé dans les applications de calculs intensifs comme le perceptual computing, les pare-feux réseau avec une inspection approfondie des paquets et l'analytique big data. Grâce au support HSA 1.0 des charges de travail peuvent être partagées entre le CPU et les coeurs graphiques hautement parallèles, offrant un environnement très économique énergétiquement.

**Détails techniques**

Le nouveau module conga-TR3 avec un brochage Type 6 est équipé d'un processeur AMD Embedded G-Series SOC GX-217GI à deux coeurs à 1,7 GHz jusqu'à 2 GHz et prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4, avec ECC en option. La nouvelle architecture AMD Graphics Core Next (GCN) Generation 3 contrôle jusqu'à deux écrans 4K Ultra HD indépendants à 60 Hz via DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0. OpenGL 4.0 et DirectX 12 sont également pris en charge pour des graphiques 3D plus rapides sous Windows 10. Les accélérateurs hardware intégrés permettent un flux vidéo HEVC basse consommation dans les deux directions.

Grâce au support HSA 1.0 et OpenCL 2.0, les charges sont directement assignées à l'unité de traitement la plus efficace. Dans les applications de sécurité critique, le processeur AMD Secure intégré fournit le cryptage et le décryptage accéléré en hardware des RSA, SHA et AES.

Le nouveau module prend en charge le brochage COM Express Type 6 avec 1x4 PCIe 3.0, 1 PEG, Gigabit Ethernet, 4 USB 3.0/2.0, 4 USB 2.0, SPI, LPC et I2C et 2 UART. La prise en charge du système d'exploitation concerne Linux et Microsoft Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7 en option. Les services de conception embarquée et de fabrication pour des cartes porteuses personnalisées ainsi qu'une large gamme d'accessoires pour faciliter la conception sont également proposés.

La data sheet et des informations complémentaires sur le nouveau module conga-TR3 sont disponibles sur :

<http://www.congatec.com/en/products/com-express-typ6/conga-tr3.html>

**A propos de Congatec**

Congatec AG, dont le siège est situé à Deggendorf, Allemagne, est un fournisseur de premier plan de modules processeurs industriels utilisant les standards Qseven, COM Express, XTX et ETX, de cartes SBC et de services EDM. Les produits de Congatec peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente. Parmi les compétences et le savoir-faire technique de Congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets. Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits de Congatec sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. La société possède des filiales à Taiwan, au Japon, Chine, USA, Australie et République Tchèque. Site web : [www.congatec.com](file:///C:\Users\desmaele\AppData\Local\Microsoft\desmaele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\desmaele\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\A0UKGA4I\www.congatec.com) ou via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

\* \* \*